



HONGJING
宏景电子

芜湖宏景电子股份有限公司

Wuhu Hongjing Electronic Co.,Ltd

948 U108材料失效分析报告

零件量测不良表

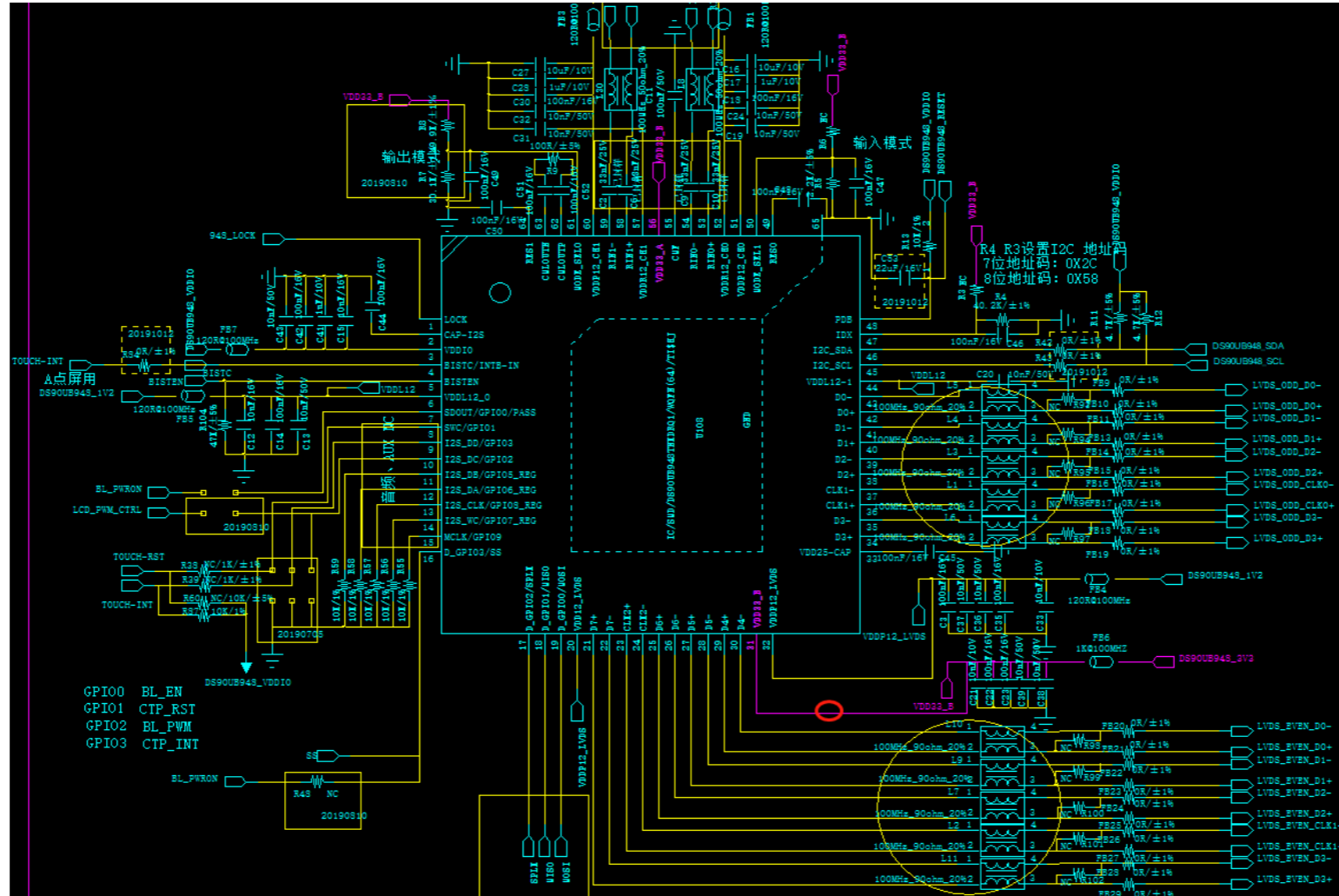
电路板名称: A6219114320A9-A(30338010-V1-1)
日期: 2024-2-27
步骤: 739

寻找设定
 测试步骤 1
 零件名称
寻找(S)

步骤	零件名称	Loc	标准值	期望值	量测值	误差%	上限	下限	高点	低点
1	TRIPRETEST	A1	22.000	0.000	1.000	+99.9	10.0	10.0	0	0
453	D3_2_1	A1	0.700V	1.500V	0.449V	-70.0	-1.0	30.0	69	1

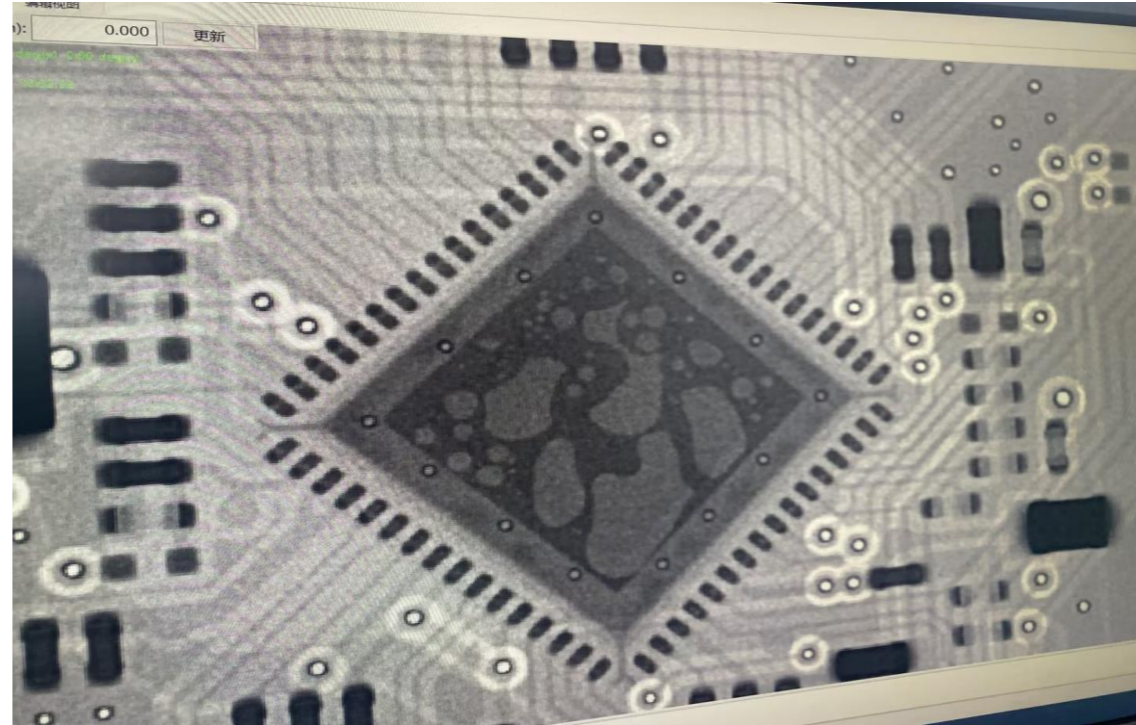
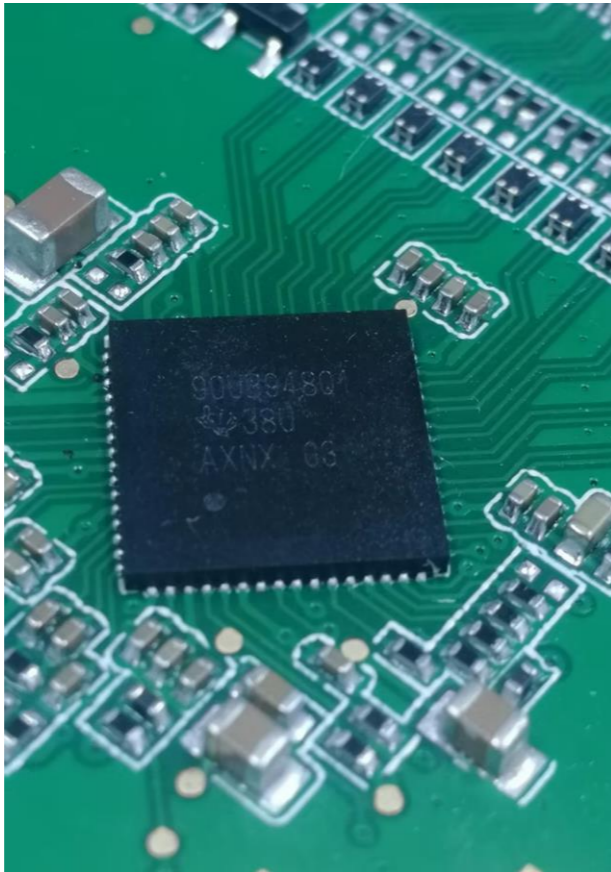
显示
保护二
Socket 通
IC 空
On-Power
Function
显示(O)
打印本页(P)
打印(F12)
退出
说明(S)
电路板检视(S)

ICT 测试测量值异常，不良板ICT测试架不同穴位复测现象不变，确认为主板功能性不良；



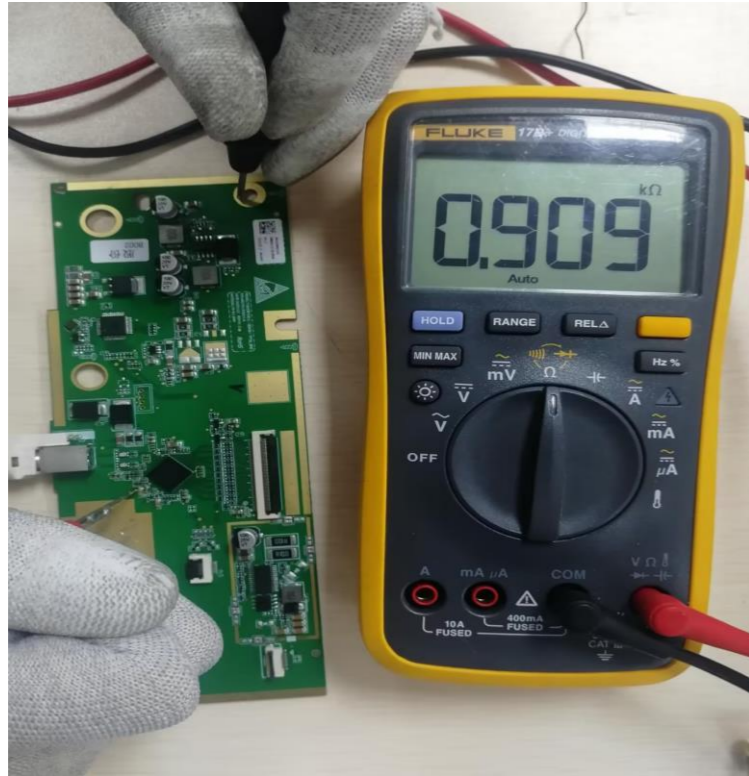
结合原理图线路分析，U108对地阻值异常，初步分析U108故障；

不良分析:

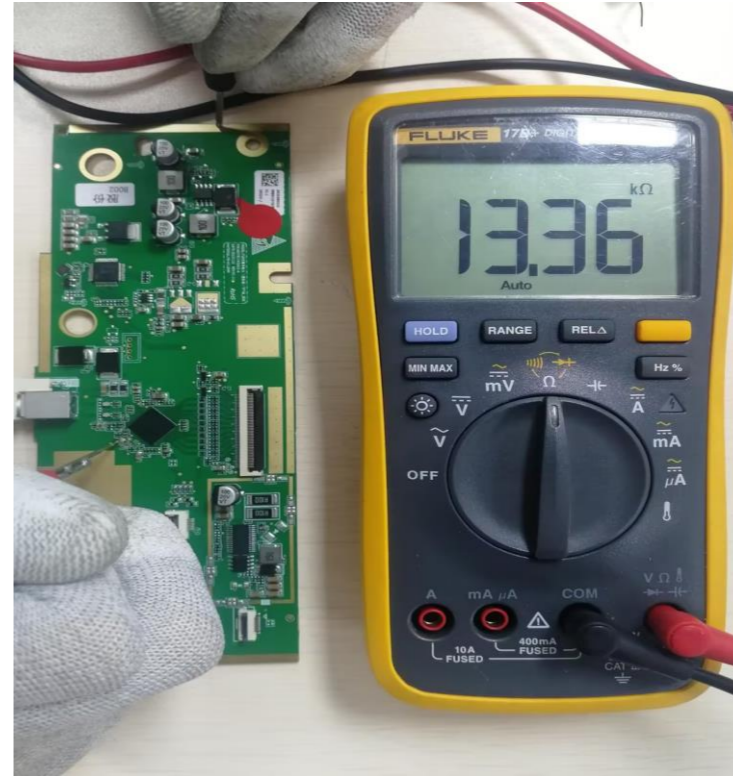


不良芯片 U108外观/X-RAY检查没有发现桥焊接，虚焊，烧焦，熔化，破裂或损坏不良现象；

不良分析:



不良板量测U108对地阻值0.9K



OK板量测U108对地阻值13K

不良板量测U108对地阻值0.9K, OK板量测U108对地阻值13K,阻值差异较大

不良分析:

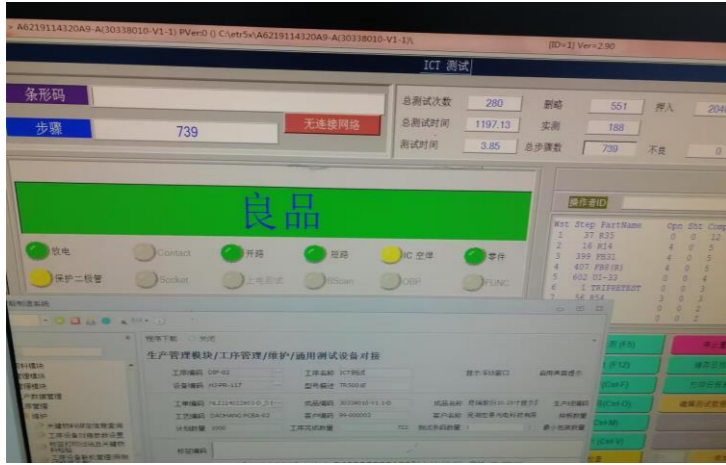


不良芯片量测U108对地阻值6.9K

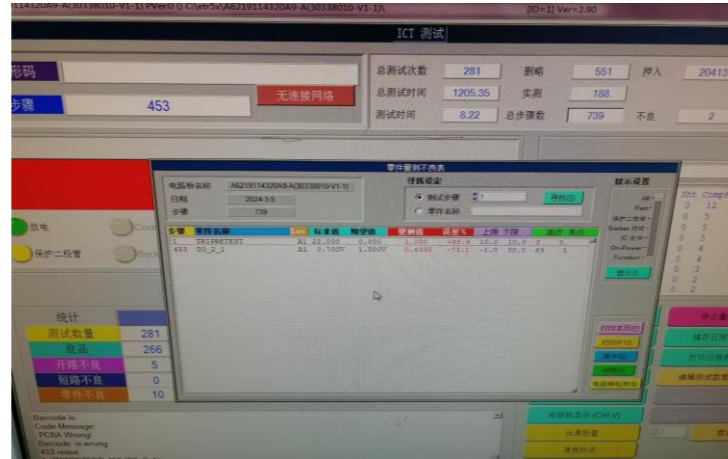


OK 芯片量测U108对地阻值41.9K

不良芯片量测U108对地阻值6.9K，OK 芯片量测U108对地阻值41.9K，阻值差异较大



不良板更换OK芯片 U108 ICT测试PASS



OK 板更换不良板芯片U108 ICT测试NG



不良板复原U108 ICT测试NG

不良板更换OK芯片 U108 ICT测试PASS, OK 板更换不良板芯片U108 ICT测试NG,不良板芯片 U506重新复原ICT测试 NG,不良现象跟随芯片U108移动;

- 1.不良芯片U108外观没有发现桥焊接，虚焊，烧焦，熔化，破裂或损坏不良现象；
- 2.经 ABA 交叉验证确认不良现象跟随芯片U108 移动，初步分析为芯片U108 内部异常导致对地阻值异常；
- 3.不良材料待反馈SQE寄给供应商进行进一步分析，以确定问题的根本原因并制定解决方案，谢谢！

材料厂商： TI

料号： DS90UB948TNKDRQ1